

복원률(Finger) 시험규격



1.적용범위

이 규격은 당사에서 시험하는 Finger의 복원률 시험에 적용한다.

2.측정장비

반복하중시험기 : 자체제작

3.측정방법

- 1) 시험전 시료의 두께를 측정한다.
- 2) 상온에서 300회/min의 속도로 시료 두께의 30%를 10,000회 되풀이 압축시킨다.
- 3) 시험이 종료 후 시료를 상온에서 30분을 방치한다.
- 4) 두께를 측정하여 복원률 계산한다.

※ 복원률(%)

$$C = \frac{t_1}{t_0} \times 100$$

C : 복원률 (%)

t₀ : 처음 시편의 높이 (mm)

t₁ : 시험후의 시험편의 높이 (mm)

다음 식으로 계산하며 시험편의 평균값으로 표시한다.

■ 그림

